

环旭电子股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立合资公司并签订相关协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 协议类型及金额: 环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“本公司”）之全资子公司 Universal Global Electronics Co., Limited（以下简称“环海电子”）与 Qualcomm Incorporated（以下简称“高通公司”）之全资子公司 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC.（以下简称“Qualcomm Technologies”）签署合资协议，拟投资新设合资公司。

● 协议生效条件: 本协议自协议双方签字盖章之日起生效

● 协议履行期限: 自本协议生效后至本协议约定的各方权利义务履行完毕为止。

● 对上市公司当期业绩的影响: 本协议的签订和履行不会对本公司 2018 年度经营业绩产生重大影响。

● 特别风险提示: 本次合资公司的设立受到政策及相关审批程序的影响，存在一定的不确定性。新设合资公司及后续注资尚需向相关部门备案，且其运营情况受到巴西当地政治状况、宏观经济环境、行业政策、经营管理等因素影响；本次新设公司存在因市场情况变化等不确定因素导致新公司业务达不到预期、从而影响公司预期收益实现的风险；新设合资公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、审议程序情况

本次签署合资协议事项尚在环旭电子董事长审批权限之内，无需经公司董事会审议。本次签署合资协议事项已经环旭电子董事长审批通过，并已经环海电子董事会审议通过。

二、协议标的和对方当事人情况

（一）协议标的的情况

环旭电子之全资子公司环海电子与高通公司之全资子公司 Qualcomm Technologies 于北京时间 2018 年 02 月 06 日于巴西圣保罗签署合资协议，拟在巴西投资新设合资公司，主营业务为研发、制造具有多合一功能的系统级封装（System-in-Package,“SIP”）模块产品，应用于智能手机、物联网等相关设备。

公司名称:新设合资公司名称未定, 将由协议签署双方共同商定。

注册资本:巴西币 1000 元

经营范围: 设计, 开发, 制造, 测试, 技术支持, 服务, 营销, 分销和销售系统级封装（System-in-Package,“SIP”）模块和其他无线行业的集成电子模块, 应用于物联网（IoT）和智能手机相关设备。

经营期限: 新设合资公司的经营期限为无限期。仅在本次签署的《合资协议》及《合资协议》后附的《股东协议》和相关法律法规的规定应当终止运营的情况下终止新设合资公司。

公司地址: 新设合资公司总部及工厂应设立在巴西联邦共和国的西圣保罗州, 具体位置由协议签署双方共同商定。

企业性质: 新设合资公司是依据巴西联邦共和国的《公司法》设立的公司法人实体。

出资比例:

股东名	股东权益
环海电子	75%
Qualcomm Technologies	25%
总计	100%

（二）协议对方当事人情况。

QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC., 是一家按照美国特拉华州法律组建和存续的公司, 注册地址为美国特拉华州威尔明顿市 251 Little Falls Drive, 总部地址为加利福尼亚州圣地亚哥 5775 Morehouse Drive, 是高通公司的全资子公司。

高通公司成立于 1985 年, 注册资本 600,000 美元, 公司住所为 5775 Morehouse Dr.San Diego, California。高通公司为 NASDAQ 挂牌上市公司, 公司简称 QCOM, 经营范围为设计、制造和销售无线通讯产品和服务。

三、协议主要条款

1、出资安排：

1) 预计总资金。经协议双方估算，合资公司前 3 年运营所需资金总额为一亿八千八百万美元（188,000,000.00 美元），其中 50% 由协议双方提供给合资公司，另外 50% 由合资公司进行融资。

2) 资本投入。根据本次签署的《合资协议》的条款，各方的出资应分三次进行，预计总金额为九千四百万美元（94,000,000.00 美元）。其中，环海电子提供 70,500,000 美元（75%），Qualcomm Technologies 提供 23,500,000 美元（25%）。

3) 分期出资。此次新设合资公司资金将分三个阶段注资，分别为 7,500,000 美元，13,875,000 美元以及 49,125,000 美元。每一阶段注资皆有合约相关条款限制，在约定条件成就后，方可进行注资。预期此次合资协议总投入金额为 70,500,000 美元。

2、技术支持：

新设合资公司的主要产品将以高通公司行业领先的技术为基础，提供包括智能手机、物联网等相关设备的整套解决方案。将简化设备工程和制造流程，并为 OEM 和相关设备制造商节约成本和时间，为智能手机、物联网等相关设备系统平台提供最佳的解决方案，以创造创新的产品和更好的用户体验。

四、说明协议履行对上市公司的影响

此次本公司与高通公司的合作，对公司的未来业务发展有着积极的影响。

1、丰富公司的 SIP 模组产品线

此次合作拟设立的合资公司，拟研发、制造具有多合一功能的 SIP 模块产品，在本公司微小化系统模组中的成功经验上此产品将进一步丰富公司的 SIP 产品线，使得 SIP 模组产品应用于更多领域。

2、拓宽公司的业务范围及生产据点

此次合作拟在巴西设立合资公司，借此契机，本公司的业务也将拓展至巴西市场。目前本公司的主要生产据点在上海、昆山、深圳、台湾及墨西哥，若此次合作能够顺利达成，本公司将新增巴西生产据点，同时未来产品也计划将打入巴西市场，本公司的业务范围将进一步扩大。

3、建立长期的战略合作关系

高通公司作为全球领先的无线技术领军企业，此次本公司与高通公司进行合作，将借助双方的技术优势、公司实力和市场影响力，在研发、生产和销售等方面开展全方位的业务合作，建立长期的战略合作关系，在夯实本公司主业的同时积极探索和布局物联网等新兴领域，从而促进本公司的业务持续稳步发展。

4、独立性影响

本协议的履行不会对本公司业务的独立性产生影响，不会因履行本协议而与协议对方形成依赖。

五、协议履行的风险分析

本次合资公司的设立受到政策及相关审批程序的影响，存在一定的不确定性。新设合资公司及后续注资尚需向相关部门备案，且其运营情况受到巴西当地政治状况、宏观经济环境、行业政策、经营管理等因素影响，对此本公司将积极推进相关审批进程，密切关注巴西当地政治状况及行业发展动态，及时发现各类风险并采取积极措施予以应对。同时，本次新设公司存在因市场情况变化等不确定因素导致新公司业务达不到预期、从而影响公司预期收益实现的风险。新设合资公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，公司将加强内部控制，完善监督管理机制，确保合资公司稳定有序地运营。本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2018年02月06日